



股票代號: 3167

大量科技股份有限公司



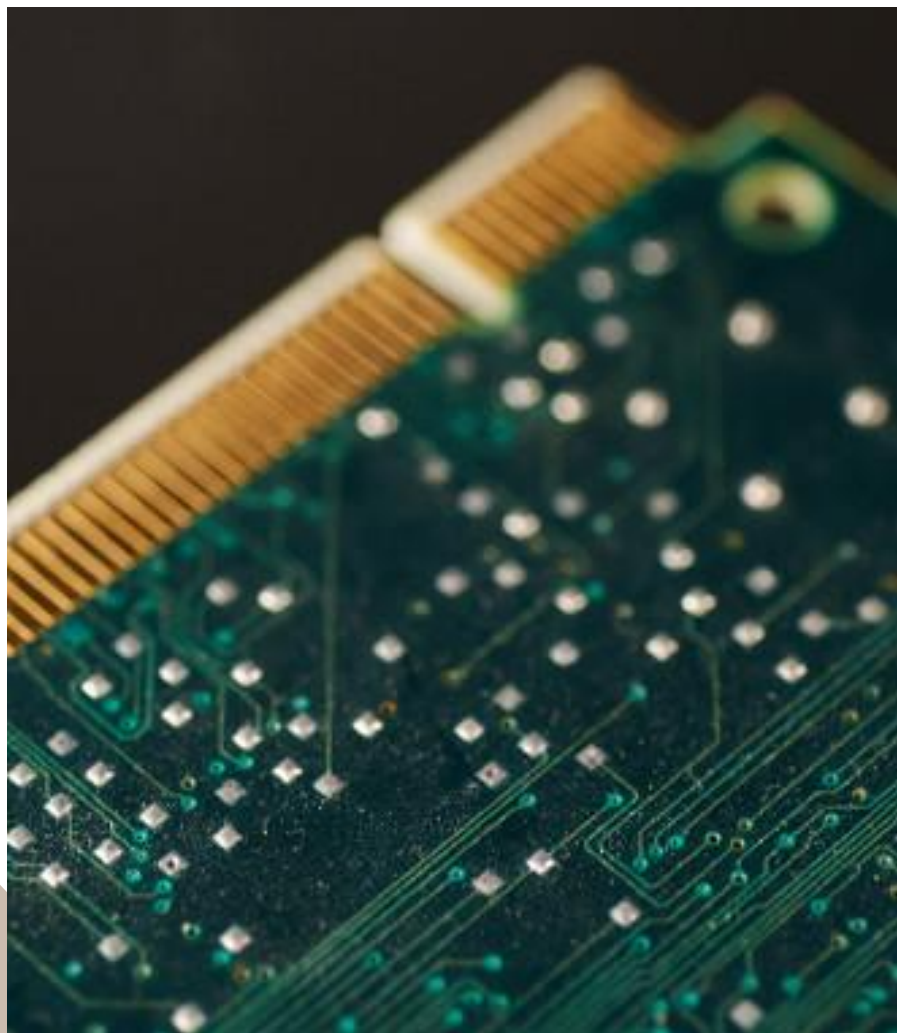
執行副總經理/簡禎祈

2021年4月15日



免責聲明

- 本簡報所提及之包括營運展望、業務狀況等屬預測性資訊內容，為本公司經由內部及外部來源所取得之資訊。
- 本公司未來實際所可能發生的營運成果，可能會因為包括但不限於市場競爭、國際經濟狀況等因素而產生差異。
- 本簡報中對未來展望，為本公司截至目前為止對外來的看法。對於這些看法，若未來有更新或調整時，本公司並不負責隨時再度提醒或更新。



公司介紹



公司概況

股票代號 3167

資本額 新台幣801,341,160元

董事長 王作京

總經理 陳尚書

員工數 580 (2021年3月, 台灣262人)

總公司 桃園市八德區友聯街49號

工廠 八德廠(21,783m²)、大陸南京廠(13,228m²)、大陸漣水廠(66,666m²)





主要經營事業

- PCB多軸鑽孔機
- PCB多軸成型機
- 鑽針研磨機
- X-ray鑽靶機
- 自動化

印刷電路板產業



- 檢測設備
 - Vision系列
 - Handler系列
- 量測演算模組設備
 - CMP Pad 量測模組

半導體產業



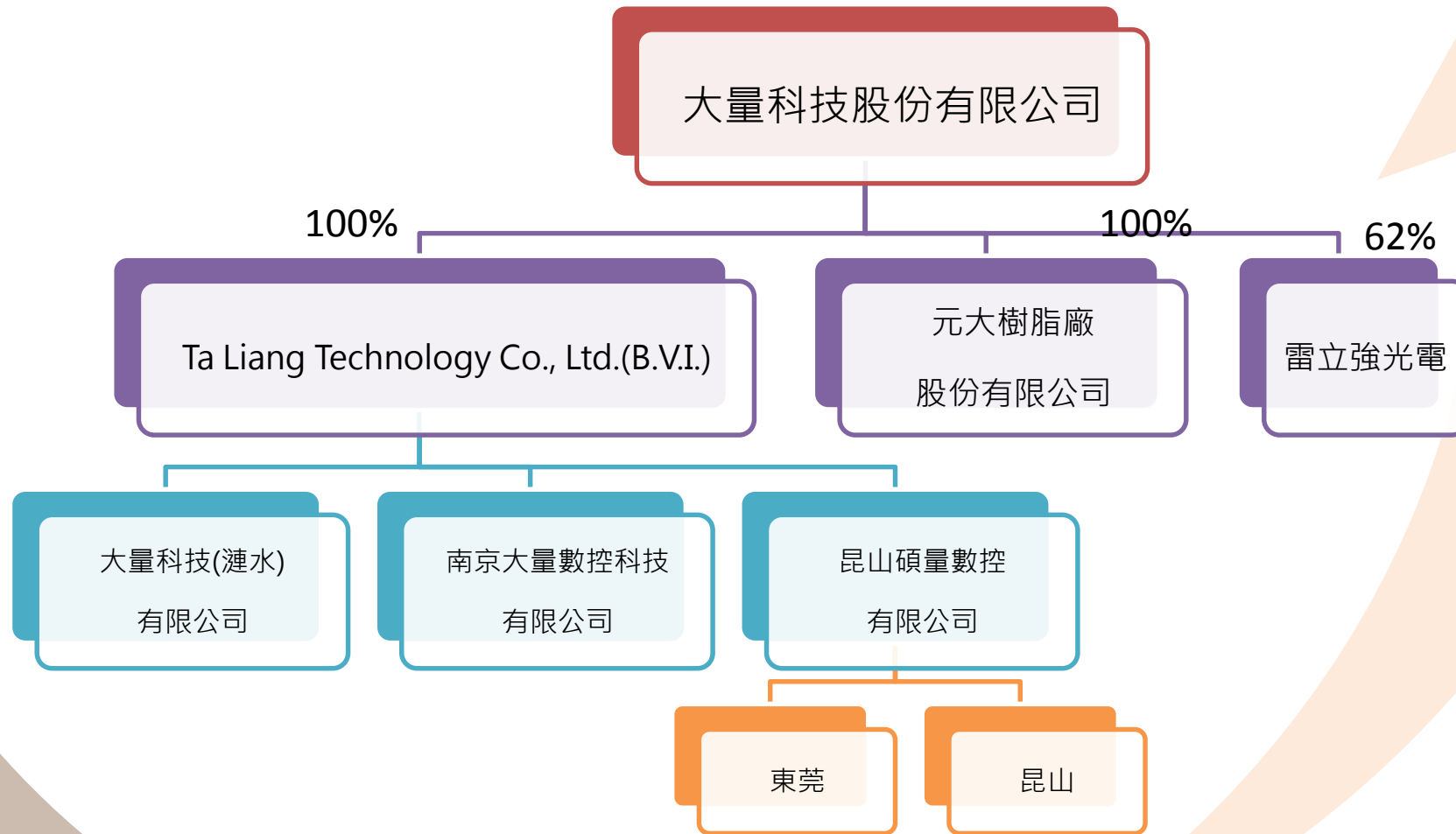
- 設計開發/採購/生產/銷售/服務/管理

大量科技團隊



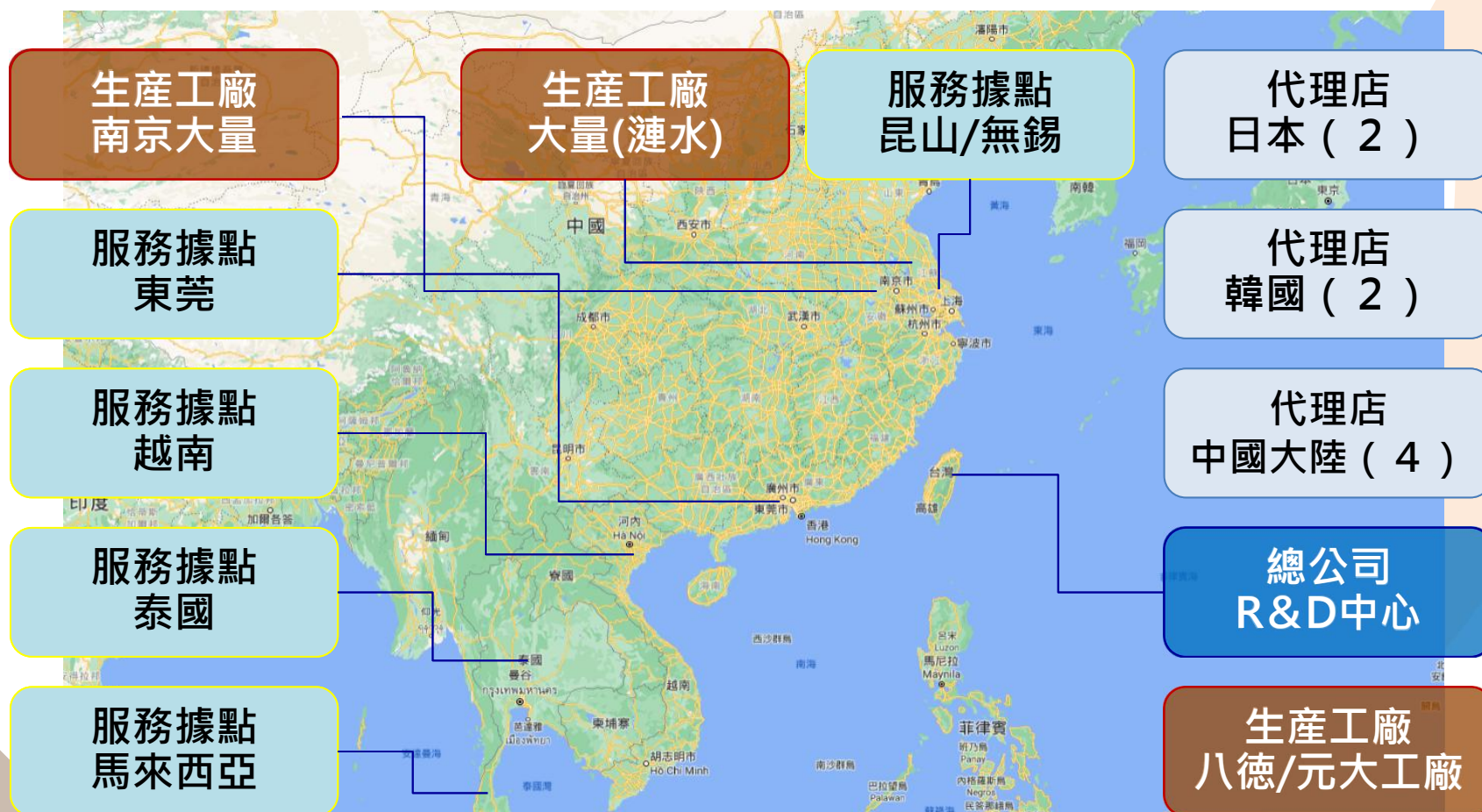


轉投資事業





生產及服務據點





產品介紹

PCB 鑽孔機



標準系列



CCD深控系列

PCB 成型機



標準系列

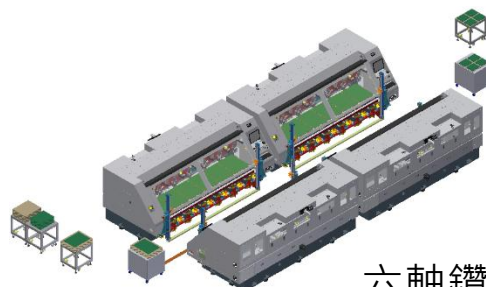


CCD深控系列

PCB 自動化

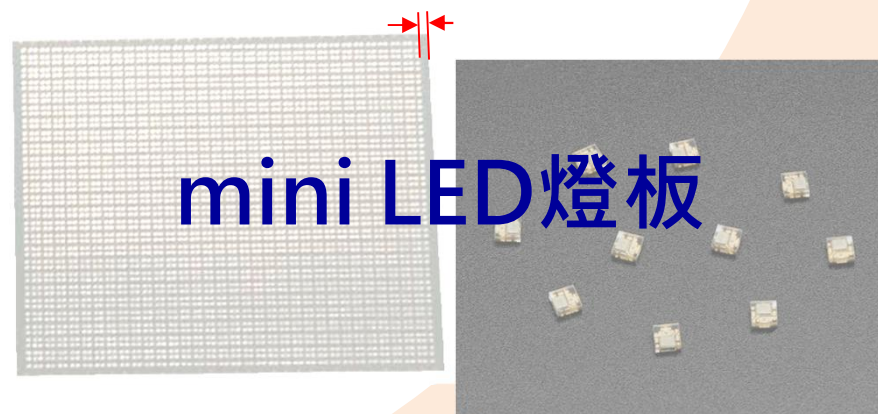
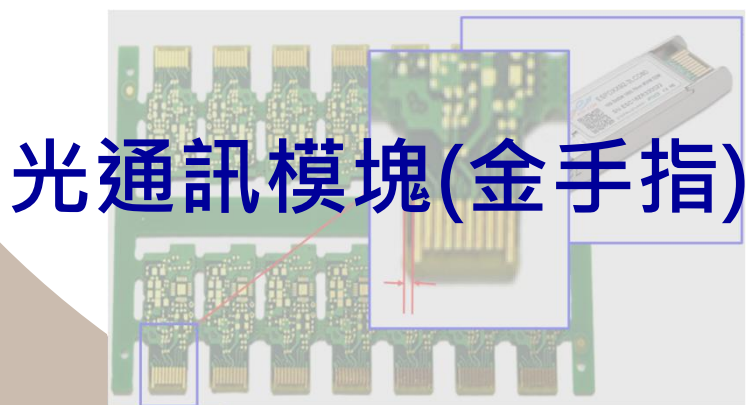
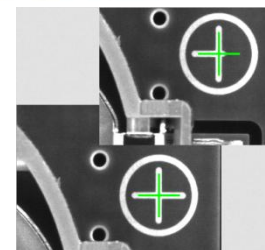
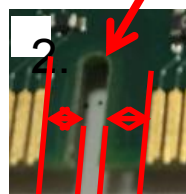
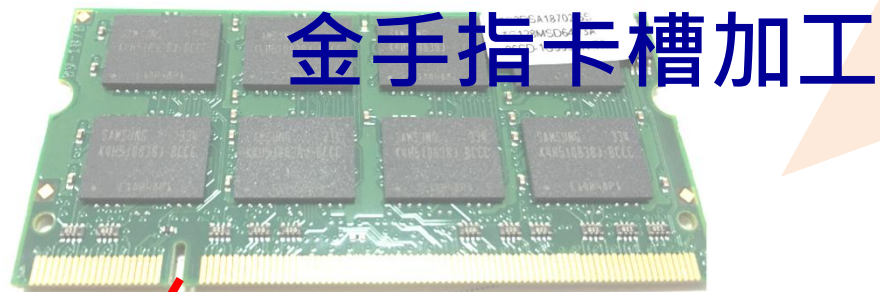
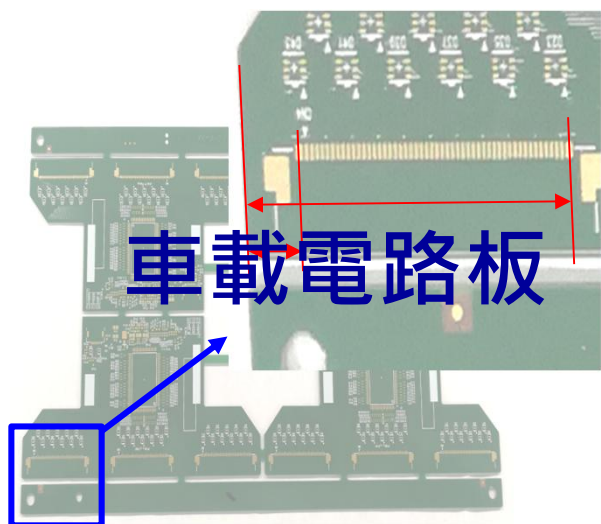


單軸鑽孔機



六軸鑽孔機

CCD成型/鑽孔機產品應用





產品介紹

光電產業系列



觸控面板加工機



玻璃邊緣塗佈機



CNC繪圖機

半導體產業系列



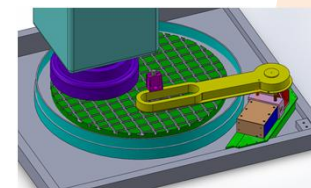
卷帶檢查機



晶圓外觀檢查機



測試編帶機



CMP Pad量測模組

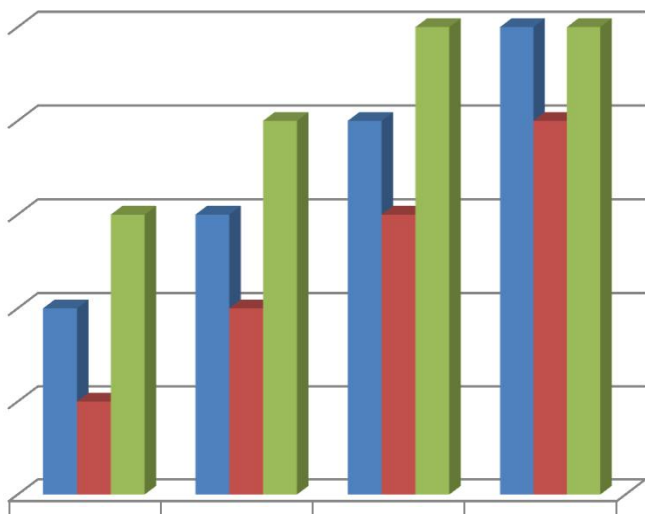
其他



X Ray 鑽靶機



鑽針研磨機



經營績效



最近三年簡明損益表

單位:新台幣千元

項目	2017年		2018年		2019年		2020年	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
營業收入	3,540,952	100%	3,986,979	100%	1,942,637	100%	2,427,607	100%
營業毛利	991,218	28%	1,118,735	28%	551,869	28%	716,067	29%
營業利益	486,851	14%	526,318	13%	209,650	11%	202,822	8%
稅前淨利	471,552	13%	612,835	15%	227,117	12%	455,211	19%
本期淨利	349,039	10%	447,860	11%	176,434	9%	415,518	17%
每股盈餘 (EPS)	4.34		5.42		2.22		5.23	



最近三年簡明資產負債表

單位:新台幣千元

項目	2017年		2018年		2019年		2020年	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
現金	831,277	17	797,161	18	1,039,792	26	743,466	14
其他流動資產	3,516,973	72	3,117,352	69	2,344,845	58	3,077,673	56
非流動資產	560,163	11	592,894	13	632,523	16	1,674,172	30
資產總計	4,908,413	100	4,507,407	100	4,017,160	100	5,495,311	100
流動負債	2,472,022	50	1,653,426	37	1,375,580	34	2,813,066	51
非流動負債	651,294	13	850,278	19	836,420	21	599,809	11
負債總計	3,123,316	64	2,503,704	56	2,212,000	55	3,412,875	62
股本	801,341	16	801,341	18	801,341	20	801,341	15
其他權益	983,756	20	1,202,362	27	1,003,819	25	1,281,095	23
權益總計	1,785,097	36	2,003,703	44	1,805,160	45	2,082,436	38
負債及權益總計	4,908,413	100	4,507,407	100	4,017,160	100	5,495,311	100



每股盈餘及配發股利

項目	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
每股盈餘	2.22	4.34	5.42	2.22	5.23
配發股利	1.5	2.5	3.5	2.0	* 3.0
配息率	68%	58%	65%	90%	57%

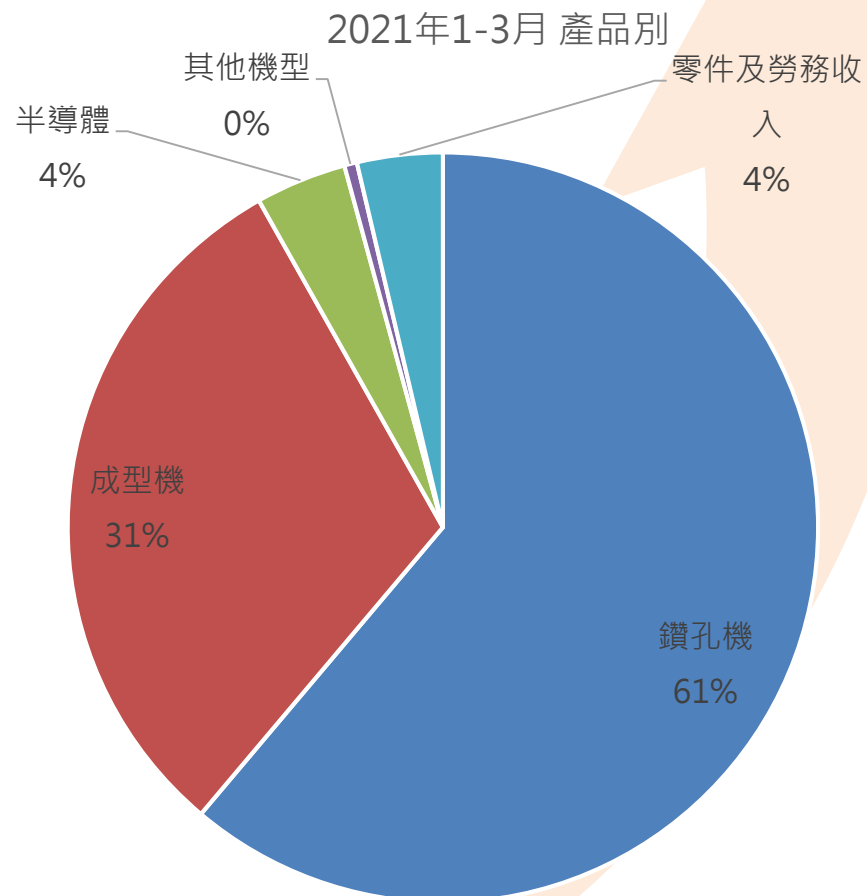
* 2021/02/26董事會通過



產品別

單位:新台幣千元

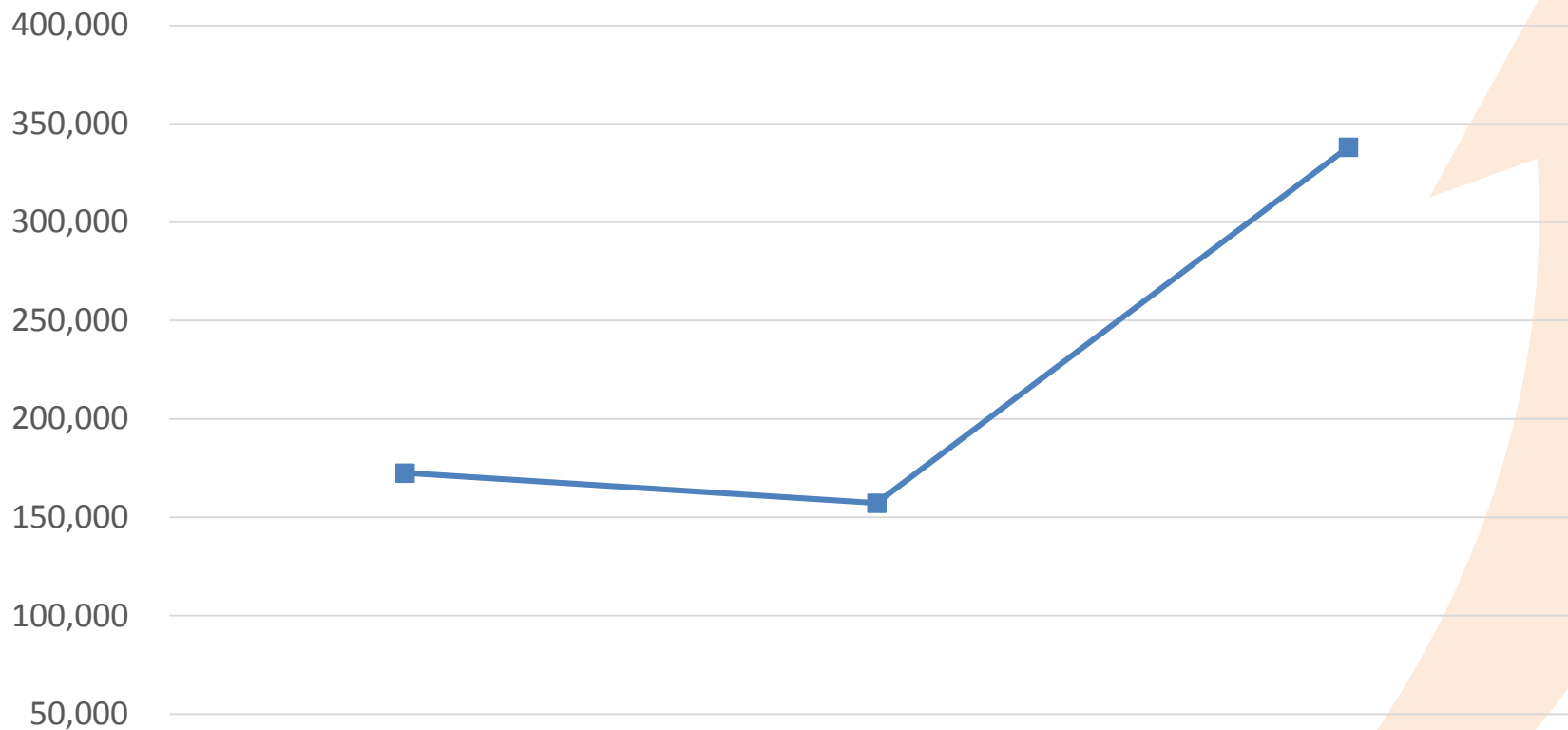
項目	2020年1-3月		2021年1-3月	
	金額	%	金額	%
鑽孔機	51,397	16%	590,956	61%
成型機	227,135	70%	293,936	31%
半導體	15,565	5%	37,655	4%
其他機型	6,413	2%	114	0%
零件及勞務收入	22,545	7%	35,340	4%
合計	323,055	100%	958,002	100%





高階機台銷售趨勢

單位:新台幣千元



■ 高階機型

2019年

172,590

2020年

157,304

2021年1-3月+已接訂單

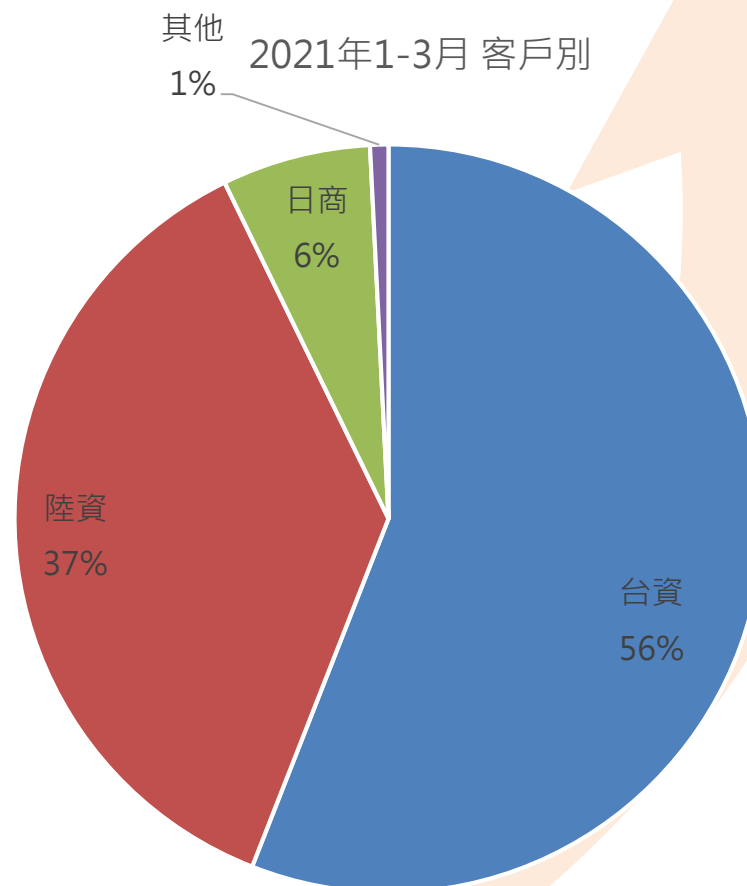
338,113



客戶別

單位:新台幣千元

項目	2020年1-3月		2021年1-3月	
	金額	%	金額	%
台資	141,088	44%	535,989	56%
陸資	176,262	55%	352,822	37%
日商	385	0%	61,636	6%
其他	5,320	2%	7,555	1%
總計	323,055	100%	958,002	100%

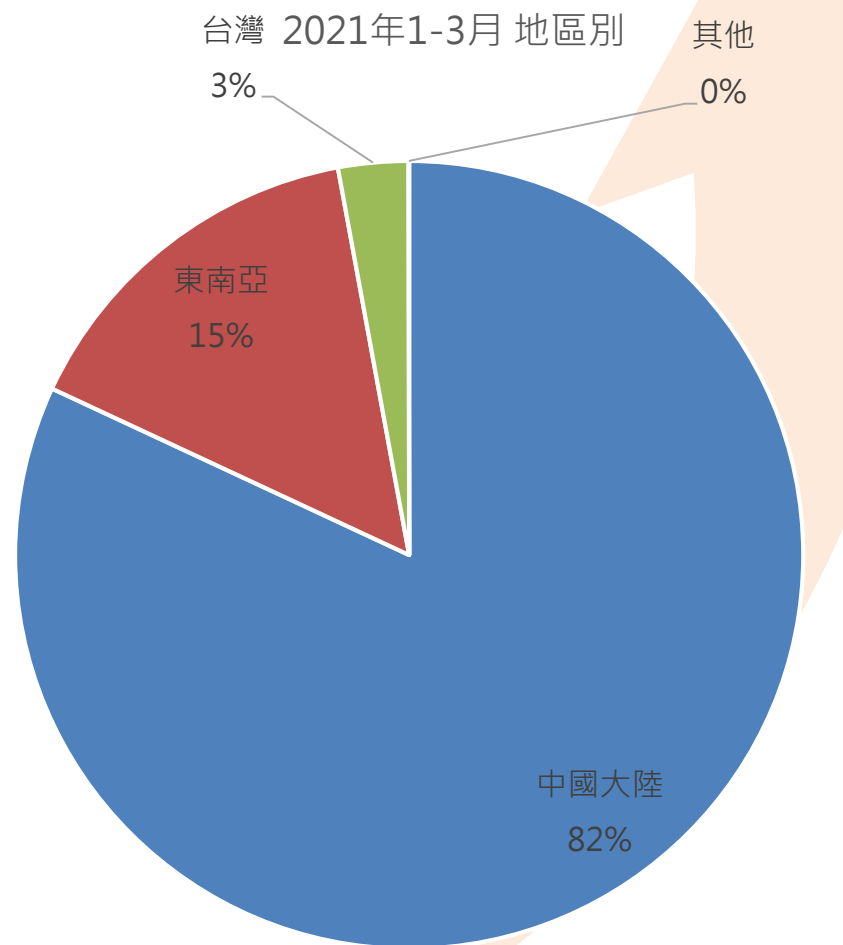




地區別

單位:新台幣千元

項目	2020年1-3月		2021年1-3月	
	金額	%	金額	%
中國大陸	249,905	77%	784,958	82%
東南亞	3,782	1%	145,181	15%
台灣	68,096	21%	27,559	3%
其他	1,273	0%	288	0%
總計	323,055	100%	958,002	100%





投入之研發費用

單位:新台幣千元

項目	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度
投入之研發費用	127,204	162,850	146,544	172,324
營業收入淨額	3,540,952	3,986,979	1,942,637	2,427,607
研發費用佔營收淨額比率	3.59%	4.08%	7.54%	7.10%



研發成果

年度	研發成果	說明
2020	CMP拋光墊智慧動態監控系統	與國立台灣科技大學產學合作開發，可最大化拋光墊使用時間，並智慧化調整製程參數。目前進行商轉前場域實做驗證。
	晶圓級(wafer-base)自動光學檢查機	透過光學架構以可見光學用於wafer-base、IC缺陷檢查，避免人為目測錯誤，提高缺陷檢出率及產出效率。
	高速輕量化六軸鑽孔機	機構原件導入特殊輕量材質，搭配使用軟體模態分析加強結構強度可達到1.5g的高加速度，提升加工效率10%以上。
2019	六軸鑽孔機/成型機自動化上下料系統	提供客戶最佳的自動化解決方案，原有客戶在不更動現場佈置的情況之下，也可以加裝本自動化單元
	並列式鑽孔機	一主機、三從機並列架構，單一核心主機系統，各從機可加工不同產品優勢，同時四台設備水、電、氣總線共用，較四台單機產品，可節省空間與耗能。
	輕量化技術	用於加快鑽孔機產品的加工效率，透過系統建模分析，發展出雙倍控制頻寬的結構設計，達到大檯面移載平台加速度1.5g的新門檻。



2020年資本支出重大訊息

一、收購元大公司100%股權

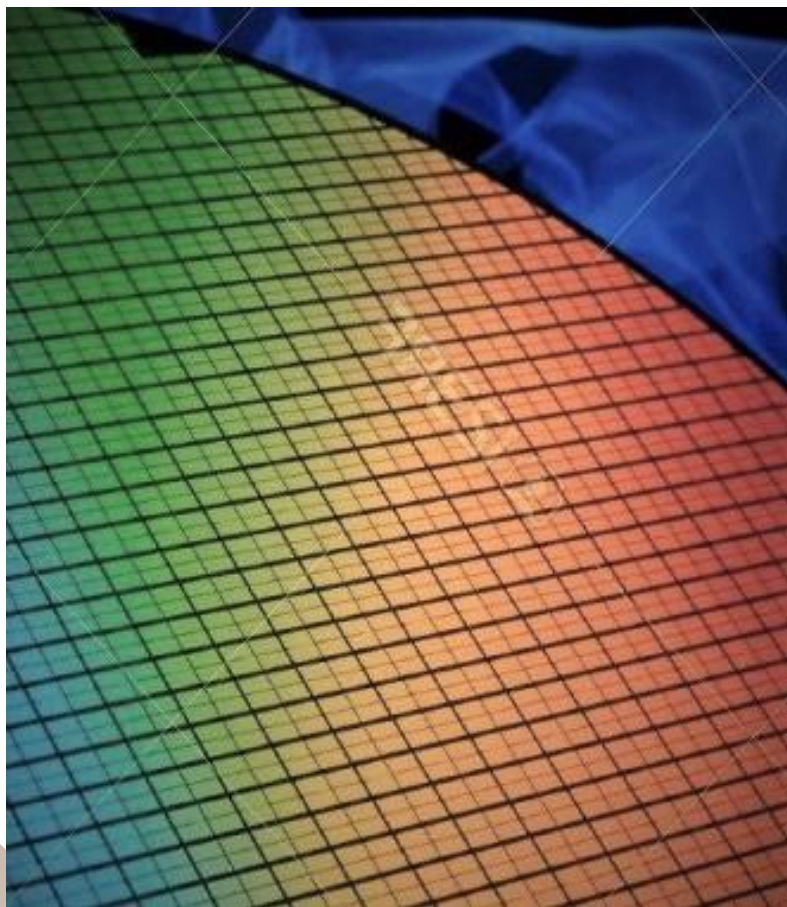
- 1.收購完成日期：2020年12月25日
- 2.目的：鄰近本公司，未來整合開發使用
- 3.內容：動用資金12.09億元
- 4.效益：節省租金支出每年700萬，整合分散廠區，土地開發利益



2020年資本支出重大訊息

二、出售楊梅土地

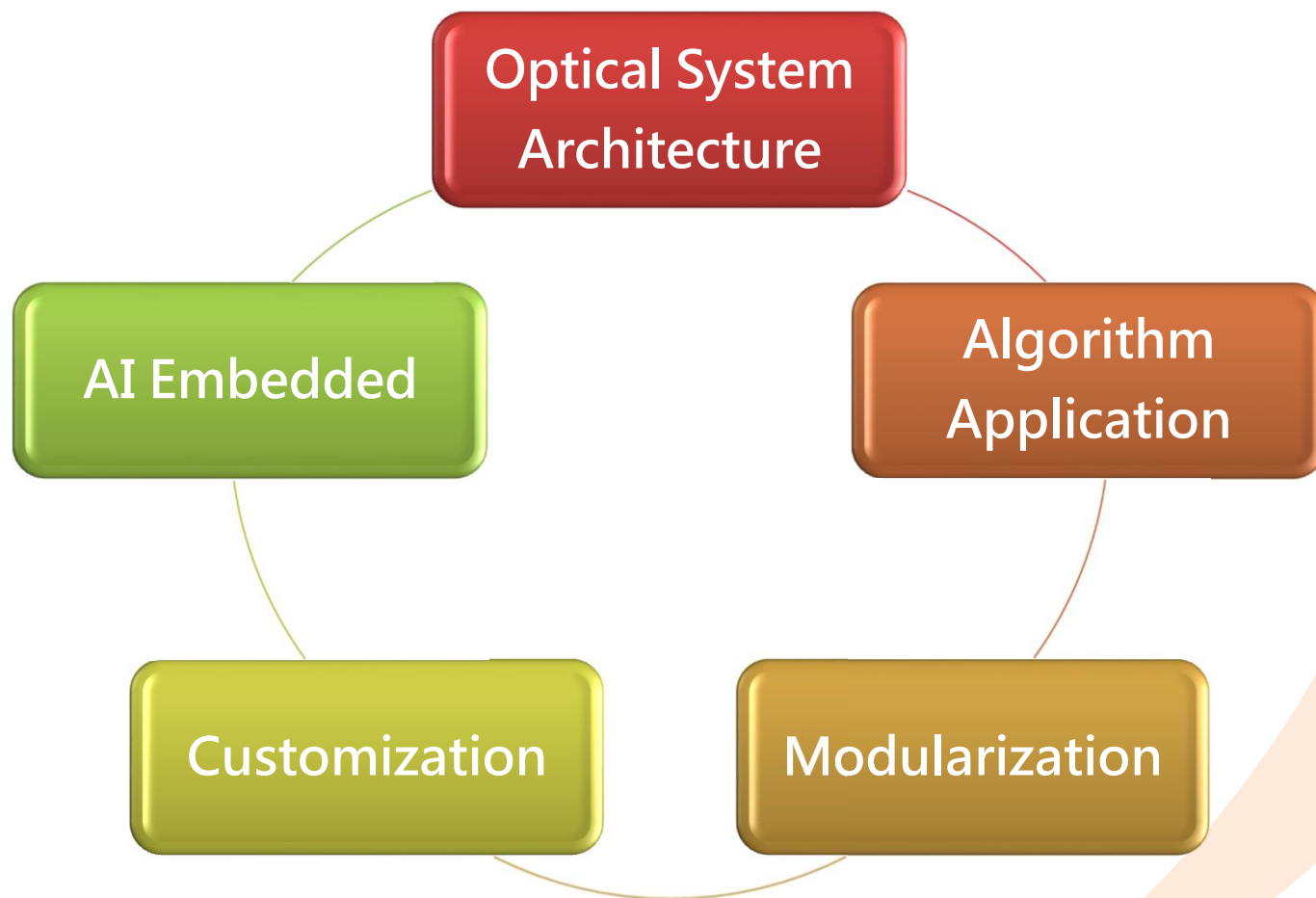
- 1.出售完成日期：2020年12月31日
- 2.目的：活化公司資產
- 3.內容：出售全部不動產，售價4.1億元
- 4.效益：出售利益2.38億元，約當EPS 2.98元
- 5.資金挹注：出售價款清償抵押借款後，現金流入2.8億元



半導體 檢測設備技術



視覺系統開發能力





半導體設備系列

Handler Series



Vision Series





Handler Series

IC Chip Test -Handler



IC AVI Handler





Vision Series

Wafer-base AOI

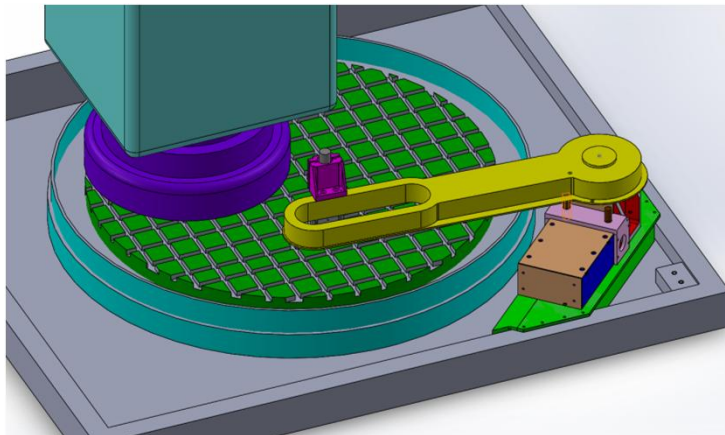


Non-Wafer-base AOI

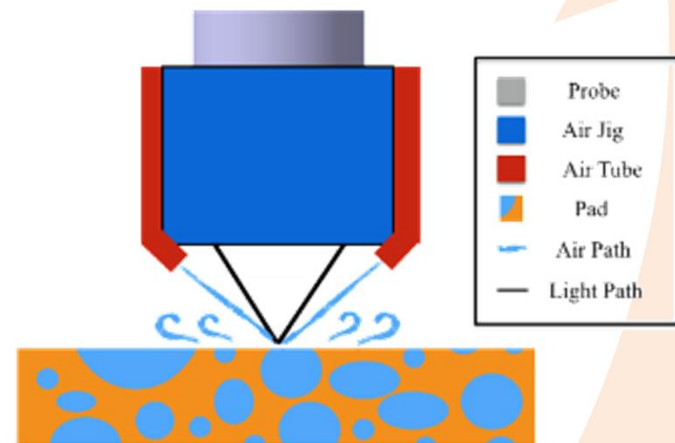




CMP PAD 量測模組



System Structure

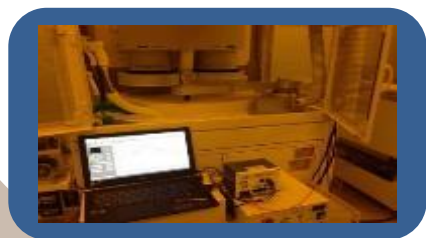
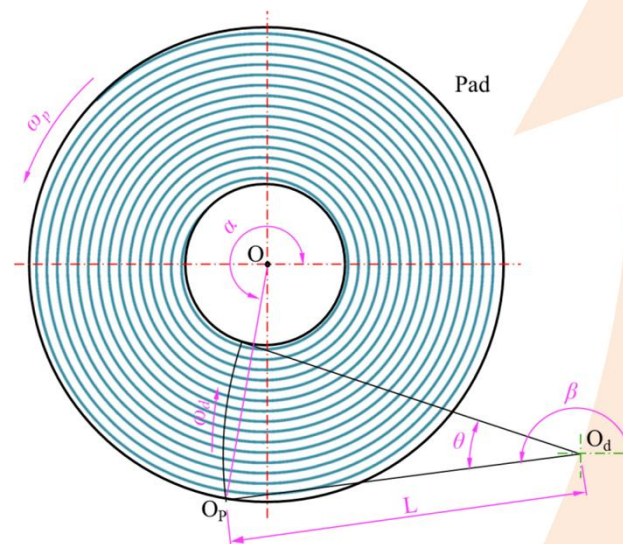
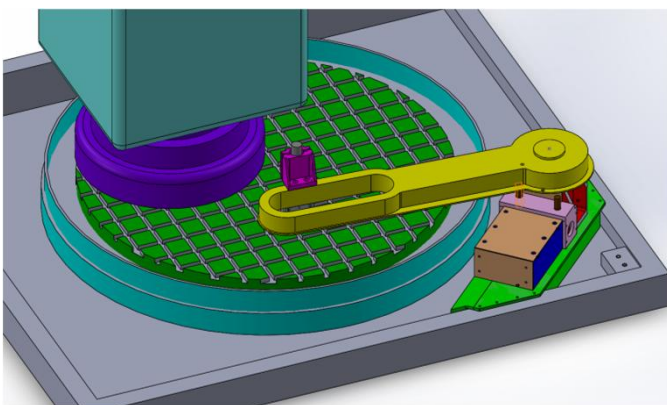


Water Layer Purge

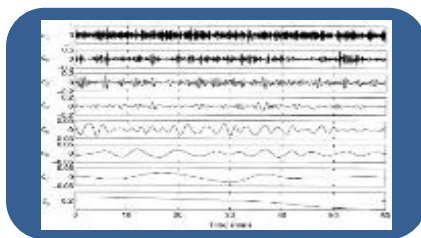


量測與分析能力

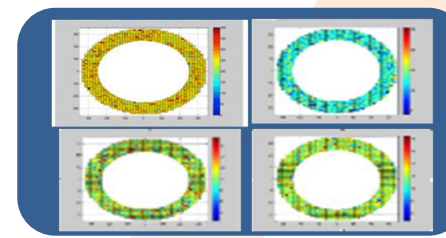
◆ Locus analysis & remodeling



Data Collection



In-process Data Monitor

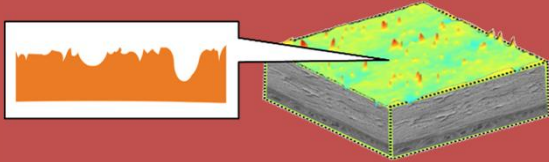


Topography Analysis



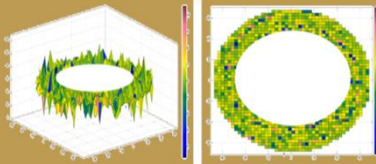
量測亮點

Roughness



- Knowing your Pad surface condition

Uniformity



- Knowing your Pad topography after conditioning

Consumption



- Knowing your Pad probably life-time



敬請指教

大量科技股份有限公司